

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年2月7日(2013.2.7)

【公表番号】特表2010-507260(P2010-507260A)

【公表日】平成22年3月4日(2010.3.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-009

【出願番号】特願2009-533462(P2009-533462)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3205 (2006.01)

H 01 L 21/768 (2006.01)

H 01 L 23/522 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/88 J

【誤訳訂正書】

【提出日】平成24年12月7日(2012.12.7)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0043

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0043】

この時点で、本手法により、二つの新規オプションが利用可能になる。一つのオプションでは、図3Iに示すように、ウエハ300をダイシングして、そのチップを薄くして新規に形成される接点326、328を露出させるか、またはウエハ300を薄くしてからダイシングすることができる。どちらの場合でもその後、要望または必要があれば、例えば、接点パッド330、332を作成する(図3J)。他のオプションでは、例えば、全体的なバイアのピッチや第2の溝が適切なサイズと空間であるのとは対照的に、非常に細いバイアを必要とする理由が接続されるポイントに関係している場合、ウエハまたは(ダイシングされている場合は)チップは、第2バイアまで簡単に薄くすることができる(図3K)。その後、図3Lに示すように、接点パッド形成プロセスの前に、またはそのプロセスの一部として、第2バイアを導体334で充填することができる。この方法で、ウエハまたはチップをより厚く維持することができる。